国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和林微纳”）首次公开发行股票并在科创板上市和2021年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对和林微纳进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与和林微纳签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解和林微纳经营情况，对和林微纳开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024年1-6月，和林微纳在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024年1-6月，和林微纳在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导和林微纳及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促和林微纳依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对和林微纳的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，和林微纳的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促和林微纳严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对和林微纳的信息披露文件进行了审阅，不存在因信息披露文件出现问题应向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024年3月13日，公司披露了《关于收到江苏证监局警示函的公告》因募集资金专户支付非募投项目相关费用未及时改正的情况，江苏证监局对公司采取了出具警示函的行政管理措施，公司已经就此事项进行了整改。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024年1-6月，和林微纳及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如应披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024年1-6月，经保荐机构核查，和林微纳不存在应及时向上海证券交易所报告而未报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024年1-6月，和林微纳未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	2024年1-6月，和林微纳不存在需要专项现场检查的情形
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行专项现场核查的其他事项。	2024年1-6月，和林微纳及相关主体在持续督导期间未出现该等情况

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术更新及产品升级风险

公司所处的精密制造行业对技术及工艺水平要求较高，公司下游应用行业包括消费电子、半导体等行业属于技术驱动型行业，高端消费类电子产品具有更新迭代速度快、发展方向不确定性大等特点。目前，公司已经形成了较为成熟的技术创新机制，持续的研发费用投入机制以及较强的研发创新能力，有助于公司能够开发出性能领先、符合市场需求的新产品。然而行业客户的多样性和行业技术的创新性，在一定程度上加大了公司新技术、新产品研发过程中的不确定因素，导致从研发到投产创收的周期较长。若未来公司不能及时跟踪、掌握并正确分析新技术、新材料或新工艺对行业的影响并采取恰当应对措施，无法及时完成原有产品的升级换代，或者科研与生产不能满足市场的要求，将对未来公司业绩增长及持续盈利能力产生不利影响。

2、人才流失风险

精密制造行业涉及的学科知识众多，且下游企业大多集中在欧美以及日韩等发达地区，行业内的企业需要充分参与国际化经营才能获得更多的业务计划，因此行业对技术和经营人才都有着较高的要求。未来，随着MEMS以及半导体芯片技术的进一步发展以及国内企业进一步融入全球产业链，对技术人才的竞争将不断加剧。如果由于薪酬或其他原因，公司的关键技术人才大量流失，或者公司无法激励现有技术人才，亦或无法吸引优秀技术人才，公司可能发生技术团队配置不足的情形，从而无法继续研发和销售新产品，无法为客户提供优质的服务，公司也可能会面临更高的招聘及培训成本，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

3、技术投入风险

公司为保持在技术方面的先进性，未来需要持续研发新产品并改进现有产品。任何新技术、新产品的研发都需要较长的时间、大量的资金。如果公司的技术研发方向不能顺应市场需求，技术变化和不断发展的标准，或者公司研发出的新产品不能满足客户对成本、规格、性能及交货周期的要求，公司将面临技术研发投入无法取得预期效果的风险。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧的风险

近年来随着中国半导体终端应用市场的不断增长，中国半导体制造、封测、材料、设备等子行业的发展迅速。伴随着全球半导体产业第三次转移的进程，中国大陆市场预计将成为全球半导体设备企业竞争的主战场，更多的企业开始尝试进入MEMS以及半导体封测相关的精密电子零组件和元器件制造业中，如果公司无法有效应对与该等竞争对手之间的竞争，公司的业务收入、经营成果和财务状况都将受到不利影响。

2、客户集中度高的风险

公司面临客户集中度较高，部分主要客户销售占比较大的风险。未来，如果主要客户的技术创新、业务布局和采购政策等业务经营发生重大变化，导致对公司相应产品需求下降，将可能对公司整体业绩产生较大影响。

3、客户认证失败的风险

公司的产品需要通过客户测试认证才能进入批量供应。因下游产品存在更新迭代，不论新老客户，每年都会有多款新产品需要进行客户认证，若客户测试认证失败，存在客户选择其他公司产品进行测试认证的可能，从而导致该款产品不能在客户该款产品中形成销售。若公司连续多款产品在同一客户中认证失败，有可能导致客户对公司产品品质产生质疑，从而导致公司不能获得新客户或丢失原有客户，导致公司收入和市场份额下降，进行对公司盈利能力产生不利影响。

4、公司业务拓展受下游市场影响较大的风险

公司的生产经营与下游市场的发展情况息息相关，而下游市场的发展情况受宏观经济发展、法律法规政策、国际贸易形势、居民消费升级等宏观因素，以及生产技术发展、行业竞争情况等多种因素影响。若未来下游市场的产业景气度下降，下游市场规模萎缩，导致公司面临需求不足甚至下滑的情况，将对公司业绩造成不利影响。

5、市场开拓失败的风险

公司产品的销售周期可能非常漫长，并且具有不确定性。从最初与客户接触到配合开发、验证直至执行采购订单，公司的销售周期一般是6到24个月甚至更长。未来公司将加大市场拓展，加快新应用领域产品开发。若公司未来无法有效拓展客户，或无法在新应用领域取得进展，将导致公司新市场或新领域拓展不利，并对公司增长的持续性产生不利影响。

6、市场开拓失败的风险

公司在2024年1-6月营业收入和净利润均呈现增长态势，但受全球经济增长动能不足、国内宏观经济变化半导体整体行业周期性波动等因素影响，公司未来经营业绩仍存在下滑的风险。公司在费用支出上已积极采取降本增效措施，同时积极新客户开发、拓展新产品线等方式提升自身竞争力和盈利能力。但为保证产品和技术竞争力，仍然需要继续投入研发，且人力成本上涨存在刚性特征，如全球宏观经济出现衰退将影响下游需求公司业绩可能出现持续下滑甚至亏损的风险。

（三）行业风险

半导体行业增速与全球经济形势高度相关，呈现出周期性波动趋势，公司下游客户为半导体产业链和消费类电子行业，其需求直接受到芯片制造、封测行业及终端应用市场的影响。

如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓，或行业景气度下滑，导致5G通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，晶圆制造、封测企业将面临产能过剩的局面，从而导致芯片产品销量和价格的下降，其营业收入、盈利能力也将随之下降。半导体厂商的资本性支出可能延缓或减少，对半导体测试的需求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。公司将积极开发客户并且尽可能为客户提供高效的测试方案，同时加大对市场空间的拓展力度，推出更多类型的产品，以减缓行业风险对公司业务的冲击。

而在半导体行业景气度提升的周期，公司必须提高产量以满足预期的客户需求，这要求公司及供应商增加库存、扩大生产能力。如果公司不能及时应对客户需求的快速增长，或者对需求增长的阶段间、持续时间或幅度判断错误，一方面公司可能会失去现有客户，另一方面也可能发生与营业收入增长不成比例的成本增加，进而可能会对公司的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生重大不利影响。

（四）宏观环境风险

半导体产品应用领域广泛，涵盖通讯、人工智能、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域，因此半导体行业与全球宏观经济形势息息相关，宏观经济的波动将直接影响半导体市场的供需平衡。由于国际经济走势变化，中美贸易摩擦走势的不确定性，可能带来宏观环境风险，影响行业整体供需结构，半导体产业成为受到影响最为明显的领域之一，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。若未来美国与中国的贸易摩擦持续升级、贸易产品限制范围进一步扩大进而发生提高关税及限制进出口的情况，公司可能出现客户流失、生产设备来源受限的情况，进而对公司的经营及财务业绩产生不利影响。

（五）财务风险

1、存货减值的风险

公司采取“以销定产、合理储备”的生产及备货模式，期末存货主要是根据客户订单、预测需求进行生产计划，储备所需的各种原材料、在产品及库存商品。

公司重要的下游终端产品更新换代相对迅速，虽然公司主要存货均有对应的订单、预测需求或生产计划，但如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，公司存货存在减值的风险。

2、业绩下滑或亏损的风险

公司2024年1-6月营业收入和净利润均呈现增长态势，但受全球经济增长动能不足、国内宏观经济变化半导体整体行业周期性波动等因素影响，公司未来经营业绩仍存在下滑的风险。公司在费用支出上已积极采取降本增效措施，同时积极新客户开发、拓展新产品线等方式提升自身竞争力和盈利能力。但为保证产品和技术竞争力，仍然需要继续投入研发，且人力成本上涨存在刚性特征，如全球宏观经济出现衰退将影响下游需求公司业绩可能出现持续下滑甚至亏损的风险。

四、重大进展事项

2024年1-6月，公司不存在重大违规事项

五、主要财务指标的变动原因及合理解释

2024年1-6月，公司主要财务数据如下所示：

主要会计数据	2024年1-6月/2024年6月30日	2023年1-6月/2023年6月30日	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	22,951.02	9,863.80	132.68
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-713.72	-1,693.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-1,342.33	-2,689.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额(万元)	212.65	-2,494.92	不适用
归属于上市公司股东的净资产(万元)	120,980.44	122,455.88	-1.20
总资产(万元)	140,184.96	137,837.92	1.70
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0611	-0.1450	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0610	-0.1449	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1149	-0.2302	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.59	-1.36	增加0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.10	-2.15	增加1.05个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	12.74	37.08	减少24.34个百分点

上述主要会计数据和财务指标变动的原因如下：

随着消费电子需求的复苏及AI、大数据等领域的快速发展，半导体行业景气度逐步呈现弱复苏态势，行业库存触底后回暖，整体经营环境较去年上半年有所好转。公司密切关注行业发展趋势，积极协调公司所处产业链上下游合作关系，优化产品和客户结构，报告期内营收规模有所增加，进而引起净利润及经营性现金流较同期增加。

综上，公司2024年1-6月主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化

经过多年的潜心研发，公司已在MEMS用精微电子零组件和元器件以及半导体芯片测试探针的生产、研发和检测领域积累了丰富的核心技术，有效提高了产品的品质和性能。公司主要产品的核心技术及其先进性如下：

序号	技术名称	适用产品	技术用途	先进性指标	先进程度	技术来源	是否专利	目前阶段
1	多排多列的模具设计和高速生产加工工艺排布技术	微屏蔽罩	1、显著提高生产效率；2、有效降低产品成本。	在高精度(高度公差控制在±0.010mm条件下)批量生产情况下，单日的精微屏蔽罩产量达到了200万只以上。	国内先进	自主研发	是	批量生产
2	微型双金属屏蔽罩模内交叉叠层技术	微屏蔽罩	创新型产品，满足高频环境下的屏蔽和隔热需求。	属于创新型产品，少数能够应用于5G高频高热工作环境的屏蔽罩产品。	国内先进	自主研发	否	批量生产
3	微型电阻焊焊点冲压成型技术	精密结构件	1、提升产品加工精度；2、提高产品生产的良品率。	1、在200微米的宽度内实现高精度焊接；2、实现焊接后的位置偏差在8微米以内。	国内先进	自主研发	是	批量生产
4	微型精密复杂异性深拉伸技术	微屏蔽罩	1、全翻边成型技术，替代原有技术；2、显著提升同类产品的生产效率；3、显著提高产品的防水防尘等级。	1、取代原有的机加工工艺，使得同类产品的产能得到有效提升，每日产出由5,000件增加至90,000件；2、全翻边技术有效阻挡了防水密封圈的松动，使防水防尘等级达到IP67以上。	国际先进	自主研发	是	批量生产
5	微型精密拉伸旋切制造技术	微屏蔽罩	1、在不破损微型模具零件的情况下实现产品的量产；2、提升产品质量，提高生产效率。	1、微小零件旋切技术，能够实现批量生产直径2.5mm的麦克风屏蔽罩；2、使用该技术生产的屏蔽罩产品的切口表面平整度度能够达到12微米以内，可直接进行焊接，免去了平面研磨环节。	国际先进	自主研发	是	批量生产
6	微型精密半导体芯片测试探针生产制造工艺	半导体片式探针	1、能够满足0.4mm引脚间距及以上的探针自动化组装；2、能够将该类产品的生产效率提高160%以上。	1、将探针产品每小时的产能从150件/小时提高到650件/小时；2、在大批量生产的条件下将产品关键尺寸精度误差控制在+/-5微米以内。	国内先进	自主研发	是	批量生产
7	QFN（方形扁平无引脚）封装芯片测试探针和基座	半导体片式探针	1、可以满足高频大电流射频芯片低插损的测试要求；2、显著提高测试系统的使用寿命。	1、可实现40GHz高频率工作环境下测试电信号的插损小于1dB；2、可负载电流大于5A；3、使探针产品的阻值小于20毫欧姆，提高产品传导性；4、使该类产品的使用寿命达到了20万次，达到了行业领先水平。	国内先进	自主研发	是	批量生产
8	测试高速GPU芯片的同轴探针	半体片式探针	1、可满足高频高速芯片的测试要求；2、显著减少信号串扰和失真。	1、减少信号串扰和失真；2、可实现70GHz带宽频率工作环境下测试电信号的插损小于1dB。3、可满足最小0.35毫米引脚间距的高速芯片测试。	国内先进	自主研发	是	批量生产
9	防震动、高可靠低阻值连接器	半体片式探针	1、可以实现工作金程无断点；2、产品可在震动环境下保持稳定工作；3、显著减少产品阻值；4、产品寿命时间长。	1、产品连接阻值小于10毫欧姆；2、产品寿命可以达到25万次以上；3、实现零插拔力；4、具备防震动功能，可用于5G通信基站。	国内先进	自主研发	是	批量生产
10	半导体测试探针套筒深拉伸工艺	半体片式探针	1、显著提升产品的生产效率；2、替代进口加工件，有效降低产品成本。	1、取代原有的机加工工艺，使得同类产品的产能得到有效提升，相同生产周期内，效率可提高近5-10倍；2、替代进口加工件，成本可降低2-3成。	国内先进	自主研发	申请中	批量生产

报告期内，公司的核心技术未出现重大变化，在微型精密半导体芯片测试探针生产制造工艺技术方面，从原来的可满足0.5mm引脚间距及以上的探针自动化组装提升到可满足0.5mm引脚间距及以上的探针自动化组装，生产效率从原来的提高70%以上提升到160%以上；在测试高速GPU芯片的同轴探针技术方面，可满足最小0.35毫米引脚间距的高速芯片测试。

七、研发支出变化及研发进展

为保证公司能够不断进行技术创新，保持产品的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2024年1-6月，公司研发投入2,922.86万元。专利方面，2024年1-6月，公司新增获得6项发明专利，4项实用新型专利。

报告期内，公司获得的知识产权如下：

项目	2024年1-6月新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	1	6	79	28
实用新型专利	2	4	104	94
外观设计专利	5	0	7	2
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	2	0
合计	8	10	192	124

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股17.71元，共募集资金354,200,000.00元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为311,957,547.17元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031号《验资报告》验证。

2、募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	存储方式	余额
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	475475836075	活期存款	13,777.31
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51902900000940	活期存款	8,702.12
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801500005528	活期存款	1,579.99
合 计			24,059.42

3、本期募集资金使用及结余情况

公司2024年1-6月首次公开发行股票募集资金的使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金专户期初余额	78,506,632.68
2	减：直接投入募集资金投资项目	13,704,800.74
3	加：用于现金管理金额	-
4	加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	153,618.75
5=1-2+3+4	截至2024年2月25日募集资金专户余额	64,955,450.69
6	募集资金节余金额转补充流动资金使用	64,931,391.27
7=5-6	截至2024年6月30日账户资金结余	24,059.42

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

2、募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行帐号	存储方式	余额
中国银行苏州工业园区分行	522278228125	活期存款	12,563,575.43
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51100800001238	活期存款	119,771,279.83
江苏银行苏州分行	30160188000371065	活期存款	2,570.23
招商银行OSA	OSA512914582065002	活期存款	7,555,637.88
合 计			139,893,063.37

3、本期募集资金使用及结余情况

公司2024年1-6月向特定对象发行股票募集资金的使用情况和结余情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金专户期初余额	552,303,930.02
2	减：直接投入募集资金投资项目	27,752,010.50
3	减：用于现金管理金额	390,000,000.00
4	加：利息收入和理财收益扣除手续费净额及汇兑损益	5,341,143.85
5=1-2-3+4	截至2024年6月30日募集资金专户结余	139,893,063.37
6	截至2024年6月30日用于现金管理余额	390,000,000.00
7=5+6	截至2024年6月30日募集资金专户余额	529,893,063.37

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的苏州银行胜浦支行、浦发银行苏州分行、中国银行苏州科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司UIGREEN株式会社为“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月，公司与UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年06月30日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币193,200.00万元，已赎回理财产品人民币193,200.00万元，不存在未赎回理财产品。

本公司报告期内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	23,000,000.00	2024-1-5	2024-2-19	1.1%-1.95%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	5,000,000.00	2024-1-2	2024-1-12	1.70%-2.4%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	33,000,000.00	2024-1-2	2024-2-9	1.70%-2.4%	已收回
合 计		61,000,000.00				

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年06月30日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币398,176.34万元，已赎回理财产品人民币359,176.34万元，39,000.00万元未赎回。

本公司报告期内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	5,000,000.00	2024-1-2	2024-1-12	1.70%-2.4%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	113,000,000.00	2024-1-2	2024-2-9	1.70%-2.4%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	5,000,000.00	2024-1-22	2024-1-31	1.70%-2.4%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	5,000,000.00	2024-2-5	2024-2-29	1.70%-2.4%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	107,000,000.00	2024-2-26	2024-3-29	1.70%-2.43%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	12,000,000.00	2024-3-4	2024-4-26	1.70%-2.43%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	70,000,000.00	2024-4-1	2024-5-31	1.70%-2.43%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	37,000,000.00	2024-4-1	2024-4-30	1.70%-2.4%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	49,000,000.00	2024-5-13	2024-6-29	1.70%-2.46%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	70,000,000.00	2024-6-3	2024-6-29	1.70%-2.4%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	188,000,000.00	2024-5-13	2024-6-18	1.19%-3.08%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	208,000,000.00	2024-5-13	2024-6-20	1.2%-3.09%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	190,000,000.00	2024-6-24	2024-8-5	1.19%-3.01%	未收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	200,000,000.00	2024-6-24	2024-8-7	1.2%-3.02%	未收回
合 计		1,259,000,000.00				

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）结余募集资金使用情况

公司于2024年2月29日披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。公司“微机电（MEMS）精密电子零部件扩产项目”、“半导体芯片测试探针扩产项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金6,495.54万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

该专项账户已于2024年8月12日注销完毕，并已将资金划转至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件：《2023年募集资金使用情况对照表》

附件

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年06月30日 单位：人民币万元

募集资金总额			31,195.75		本年度投入募集资金总额			7,888.41		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			25,937.31		
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
微机电(MEMS)精密电子零部件扩产项目	否	14,106.13	12,576.10	12,576.10	772.70	12,107.26	-468.85	96.27	2024年3月	不适用	不适用	否
半导体芯片测试探针扩产项目	否	7,619.65	7,619.65	7,619.65	10.24	6,894.94	-724.71	90.49	2024年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	587.54	6,935.11	-4,064.89	63.05	2024年3月	不适用	不适用	否
合计		32,725.78	31,195.75	31,195.75	1,370.48	25,937.31	-5,258.44	83.14				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		本公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将研发中心建设项目的预定可使用状态延期由2023年3月延至2024年3月。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-019)。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)募投项目先期投入及置换情况1、首次公开发行股票募集资金情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。										
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(八)结余募集资金使用情况”										
募集资金其他使用情况		无										

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四